



Coordenação-Geral de Tributação

Solução de Consulta nº 98.381 - Cosit

Data 14 de setembro de 2017

Processo

Interessado

CNPJ/CPF

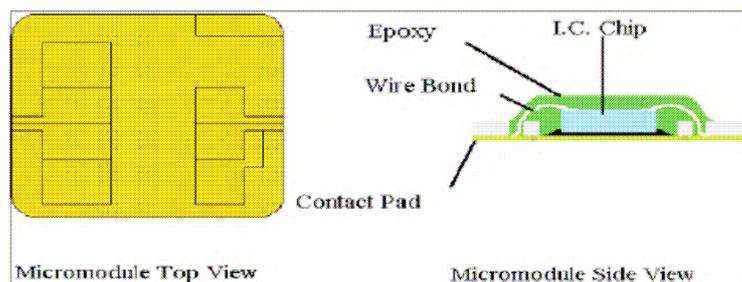
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS

Código NCM: 8542.31.90

Mercadoria: Circuito integrado eletrônico monolítico controlador, contendo microprocessador, memórias e outros componentes, todos criados na massa do material semicondutor, montado (isto é, encapsulado no seu invólucro de plástico e provido das suas conexões elétricas com aparência de um circuito impresso), do tipo utilizado em cartão inteligente, apresentado em uma tira com duas fileiras contendo diversos circuitos e acondicionada em carretel ("rolo de chips"), tecnicamente denominado "módulo microchip para cartão smartcard".

Dispositivos Legais: RGI 1 (Nota 9 b) do Capítulo 85 e texto da posição 85.42), RGI 6 (textos das subposições 8542.3 e 8542.31) e RGC 1 (texto do item 8542.31.90) da NCM constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 2016, IN RFB nº 1.459, de 2014, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e alterações posteriores.

Relatório



Fundamentos

2. Trata-se de circuito integrado eletrônico monolítico controlador, contendo microprocessador, memórias e outros componentes, todos criados na massa do material semicondutor, montado (isto é, encapsulado no seu invólucro de plástico e provido das suas conexões elétricas com aparência de um circuito impresso), do tipo utilizado em cartão inteligente, apresentado em uma tira com duas fileiras contendo diversos circuitos e acondicionada em carretel ("rolo de chips"), tecnicamente denominado "módulo microchip para cartão smartcard".

3. A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se, conforme o caso, nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).

4. A RGI 1, aplicável em todos os casos, dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo: para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas RGI 2 a 6.

5. À primeira vista, existem duas posições da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) passíveis de abarcar o "Chip para Cartão Inteligente": a posição 85.23 onde estão literalmente enquadrados os "Cartões inteligentes ("smart cards")" e a posição 85.42 que compreende os "Circuitos integrados eletrônicos".

6. A definição da expressão "cartões inteligentes ("smart cards")" que consta na descrição da posição 85.23 encontra-se na Nota 5 b) do Capítulo 85, verbis:

5.- *Na aceção da posição 85.23:*

a) ...

b) *entende-se por cartões inteligentes ("smart cards") os cartões que comportem, embebidos na massa, um ou mais circuitos integrados eletrônicos (um microprocessador, uma memória de acesso aleatório (RAM) ou uma memória somente de leitura (ROM)), em forma de chips. Estes cartões podem apresentar-se munidos de contatos, de uma tarja (pista) magnética ou de uma antena embebida, mas não contêm outros elementos de circuito ativos ou passivos.*

7. Já a definição da expressão "circuitos integrados" na aceção da posição 85.42 encontra-se na Nota 9 do Capítulo 85:

9.- *Na aceção das posições 85.41 e 85.42, consideram-se:*

(...)

b) *Circuitos integrados:*

1º) *Os circuitos integrados monolíticos em que os elementos do circuito (diodos, transistores, resistências, condensadores, indutâncias, etc.) são criados essencialmente na massa e à superfície de um material semicondutor (por exemplo, silício impurificado (dopado), arsenieto de gálio, silício-germânio, fosfeto de índio), formando um todo indissociável;*

(...)

Na classificação dos artigos definidos na presente Nota, as posições 85.41 e 85.42 têm prioridade sobre qualquer outra posição da Nomenclatura, exceto a posição 85.23, suscetível de os incluir, em particular, em razão de sua função.

8. Normalmente a posição 85.42 tem precedência sobre as demais posições da NCM, entretanto essa precedência inexistente para os produtos da posição 85.23.

9. Analisando-se atentamente os dizeres da Nota 5 b), constata-se que o "cartão inteligente" é um cartão propriamente dito (por exemplo, um cartão de crédito) que contém embutido obrigatoriamente pelo menos um CI (microprocessador e/ou memória) em forma de chip. Ademais, esse cartão pode conter contatos elétricos, tarja magnética ou antena embebida, mas não pode conter outros elementos de circuito eletroeletrônico.

10. Em outras palavras, essa Nota 5 descreve um produto de estágio industrial posterior ao do componente consultado. O cartão descrito é um produto que incorpora um circuito integrado idêntico ao sob análise. Portanto são artigos distintos.

11. Poder-se-ia pensar em dizer que o artigo sob consulta já é um "cartão inteligente", quicá um cartão incompleto, visto que já possui as características essenciais de um cartão inteligente. "Inteligente" realmente ele já é, afinal trata-se um microprocessador de alta tecnologia, mas ainda não é cartão, e essa é uma condição obrigatória para denominar na NCM uma mercadoria como "cartão inteligente" (essa obrigatoriedade está explicitada na Nota 5). Assim, neste caso não é aplicável a RGI 2 a), que diz que um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.

12. Passamos então a examinar a possibilidade de enquadrar o produto na posição 85.42 como circuito integrado eletrônico.

13. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decreto nº 435, de 28 de janeiro de 1992 e com seu texto atualizado pela Instrução Normativa RFB nº 807, de 11 de janeiro de 2008 (Suplemento ao Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 2008), e atualizações posteriores, relativas aos produtos da posição 85.42, assim descrevem os circuitos integrados monolíticos, verbis:

Os circuitos integrados monolíticos são microestruturas nas quais os elementos de circuito (diodos, transistores, resistências, capacitâncias, indutâncias, etc.) são criados na massa (essencialmente) e na superfície de um material semicondutor, mesmo composto (silício dopado, por exemplo) e formam então um todo indissociável. Os circuitos integrados monolíticos podem ser digitais, lineares (analógicos) ou digitais-analógicos.

Os circuitos integrados monolíticos podem apresentar-se:

1º) *Montados, isto é, já providos das suas conexões, encapsulados ou não nos seus invólucros de metal, de cerâmica ou de plástico. Estes invólucros podem ter, por exemplo, a forma de cilindros ou de paralelepípedos;*

2º) *Não montados, isto é, sob a forma de microplaquetas (chips), freqüentemente retangulares, em geral de alguns milímetros de lado;*

3º) *Sob a forma de discos (wafers) ainda não cortados em microplaquetas (chips).*

Podem citar-se como circuitos integrados monolíticos:

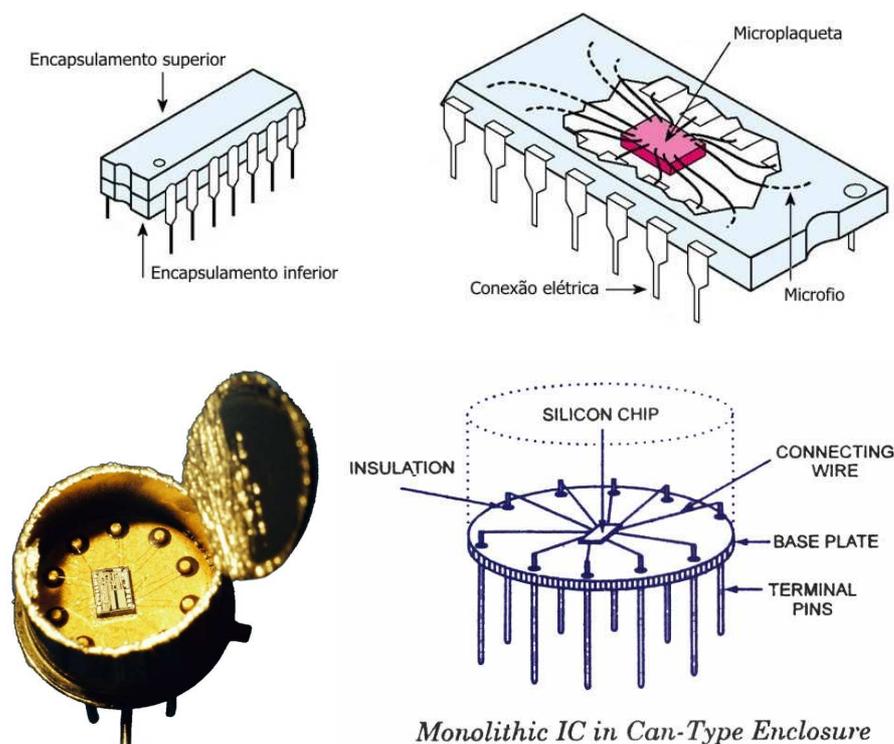
1º) *Os semicondutores de óxido metálico (tecnologia MOS);*

2º) *Os circuitos obtidos por tecnologia bipolar;*

3º) *Os circuitos obtidos pela associação das tecnologias MOS e bipolar (tecnologia BIMOS).*

14. O produto em tela atende tanto aos dizeres da Nota 9 b) do Capítulo 85, reproduzida no item 5 acima, quanto aos esclarecimentos descritos nas Nesh retro. Portanto, o produto pode ser considerado um circuito integrado eletrônico.

15. Observando-se as partes constitutivas do produto em análise, constata-se que ele possui as mesmas partes de um circuito integrado eletrônico montado nos formatos tradicionais, a saber: microplaqueta (chip propriamente dito), conexões elétricas, microfios que interligam a microplaqueta às conexões elétricas e encapsulamento. Abaixo, imagens de alguns chips com montagem tradicional:



16. Comparando-se as partes dessas montagens tradicionais com as partes da montagem do chip em análise, verifica-se que todos possuem partes equivalentes, apenas são alteradas as formas e/ou dureza de cada parte integrante. A diferença que mais chama a atenção são as

conexões elétricas, que nos chips com montagem tradicional são no formato de pinos (imagens do item acima) ou são para montagem em superfície (SMD), enquanto que no produto consultado são superfícies obtidas possivelmente pela mesma tecnologia utilizada na fabricação de placas de circuito impresso.

17. O fato de uma das faces do chip montado ser semelhante a uma placa de circuito impresso (PCI) não implica que a microplaqueta está montada em uma PCI. Essa PCI é, na realidade, o lado inferior do encapsulamento do chip para cartão inteligente, e equivale ao conjunto das conexões elétricas de um encapsulamento tradicional.

18. Pelo exposto, conclui-se que o chip para cartão inteligente objeto desta consulta classifica-se na posição 85.42 da NCM por aplicação da RGI 1.

19. A posição 85.42 se desdobra em subposições de primeiro nível:

85.42	Circuitos integrados eletrônicos.
8542.3	- Circuitos integrados eletrônicos:
8542.90	- Partes

20. A RGI 6, em sua primeira parte, estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas. Uma vez que se trata de circuito integrado eletrônico, a mercadoria sob consulta está incluída na subposição de primeiro nível 8542.3, que se subdivide em subposições de segundo nível:

8542.3	- Circuitos integrados eletrônicos:
8542.31	-- Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos
8542.32	-- Memórias
8542.33	-- Amplificadores
8542.39	-- Outros

21. O CI sob análise é basicamente um controlador combinado com memórias e se inclui, por isso, na subposição de segundo nível 8542.31, que possui desdobramentos regionais:

8542.31	-- Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos
8542.31.10	Não montados
8542.31.20	Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - <i>Surface Mounted Device</i>)
8542.31.90	Outros

22. A classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela Regra Geral Complementar 1 da NCM. Essa Regra determina que, em nível de itens e subitens, a classificação é realizada pelas Regras Gerais do Sistema Harmonizado.

23. Visto que se trata de CI montado, porém não para montagem em superfície (SMD), classifica-se no item 8542.31.90.

Conclusão

24. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1 (Nota 9 b) do Capítulo 85 e texto da posição 85.42), RGI 6 (textos das subposições 8542.3 e 8542.31) e na Regra Geral Complementar da Nomenclatura Comum do Mercosul RGC 1 (texto do item

8542.31.90) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.º 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n.º 8.950, de 2016, na IN RFB n.º 1.459, de 2014, e em subsídios extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decreto n.º 435, de 1992, e atualizadas pela Instrução Normativa RFB n.º 807, de 2008, e alterações posteriores, o artigo sob consulta classifica-se no código NCM **8542.31.90**.

Ordem de Intimação

Aprovada a Solução de Consulta pela 3ª Turma, constituída pela Portaria RFB n.º 1.921, de 13 de abril de 2017, à sessão de 14 de setembro de 2017. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 28 da Instrução Normativa RFB n.º 1.464, de 8 de maio de 2014.

Remeta-se o presente processo para ciência do interessado e demais providências cabíveis.

(Assinado Digitalmente)

FERNANDO KENJI MYAMOTO

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Membro da 3ª Turma

(Assinado Digitalmente)

RUTE MEDEIROS MORAES DE PALMA

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Membro da 3ª Turma

(Assinado Digitalmente)

MARCOS DE MEDEIROS GONÇALVES

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Membro da 3ª Turma

(Assinado Digitalmente)

SURA HELEN COT MARCOS

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora

(Assinado Digitalmente)

DANIELLE CARVALHO DE LACERDA

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Presidente da 3ª Turma